

株式会社フジミインコーポレーテッド

株主通信 2011年6月発行

FUJIMI TODAY

Vol.
32

2010.4.1~2011.3.31

特集

SPECIAL
FEATURE

様々なニーズに

新しい組織で応えたい

つよく、やさしく、おもしろい

FUJIMI

証券コード 5384

東日本大震災の被災地の皆様には心よりお見舞い申し上げますとともに、犠牲になられた方々のご遺族の皆様に対し深くお悔やみを申し上げます。

被災地の一日も早い復興を心より祈念いたします。

当社グループを取り巻く環境は、アジア諸国を中心とする新興国の持続的な成長や各国の経済政策などにより、総じて回復基調で推移したものの、中東諸国の国際情勢不安に端を発した原油価格の高騰やわが国における東日本大震災及びそれに伴う東京電力福島第1原子力発電所事故による電力供給問題などの影響により、先行きは不透明な状況にあります。半導体市場は総じて緩やかな回復基調で推移しましたが、第3四半期に入り、一般向けパソコン需要が市場予想を下回り、一部に在庫調整等の動きも見られました。

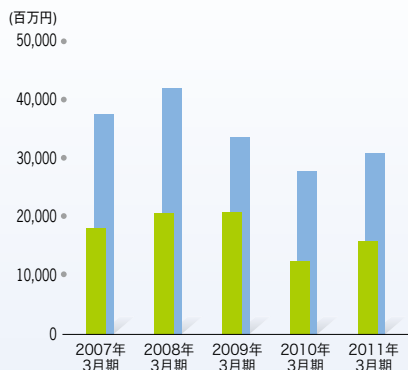
こうした中、当社グループでは一丸となって売上の拡大を図るとともに、コスト削減に努めた結果、2011年3月期の連結業績は、売上高30,869百万円（前期比9.6%増）、うち製品売上高30,407百万円（前期比9.7%増）となりました。また、利益面では、営業利益2,777百万円（前期比85.6%増）、経常利益2,817百万円（前期比65.8%増）、当期純利益1,820百万円（前期比56.7%増）となりました。

中長期経営計画3年目の今年は新たな成長に向けての「基礎体力作り」・「種まき」と位置づけた9年の中長期経営計画の第一期の最後の年です。今期から営業と開発を一体化し、市場やお客様のニーズにより迅速かつ的確にお応えできるよう組織を再編いたしました。

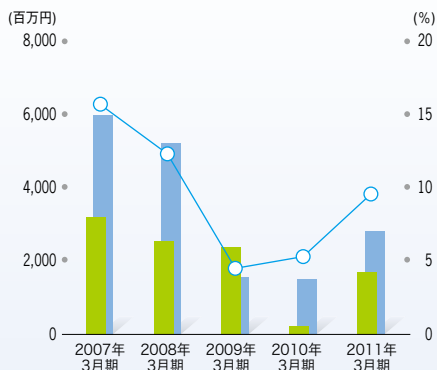
また、『総務部』から『人事部』を独立させ、同時に新たな社内人事・教育制度がスタートするなど、成長のため不可欠な「人材育成」についても体制が整いつつあります。

連結決算ハイライト ■ 上半期 ■ 通期

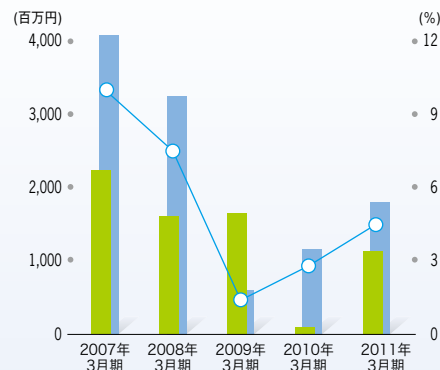
▶ 売上高



▶ 営業利益・売上高営業利益率



▶ 当期純利益・ROE



また、次の事業の柱の発掘・育成の動きも活発化しています。

当社が理想とする『強く、やさしく、面白い』会社の実現を目指して、企業風土そのものも見つめ直していく必要があると感じ、二年前から風土変革に着手しております。

今期はその動きを定着させ、より確かな動きとすることで、中長期経営計画の最初のステップである成長への基礎固め・体制作りを完了させたいと思います。

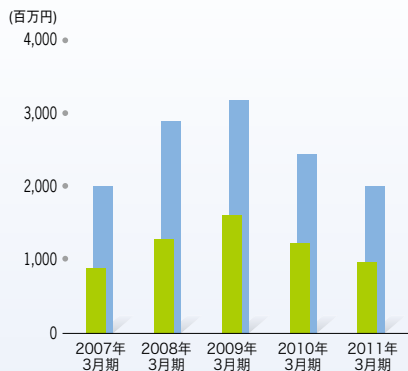
皆様のご厚情に感謝いたしますとともに、これまでと変わらぬご支援をいただきますようお願い申し上げます。



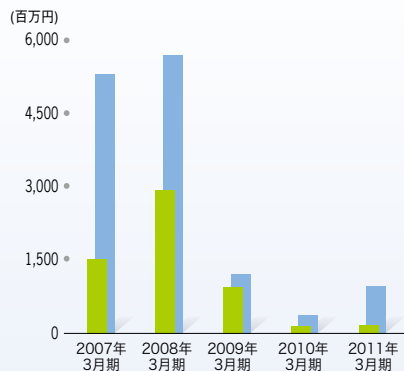
代表取締役社長

関 敬史

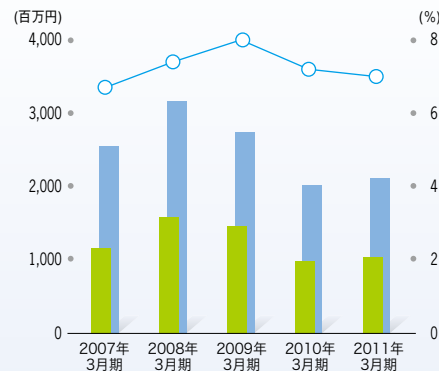
▶ 減価償却費



▶ 設備投資額



▶ 研究開発費・対売上高比率



特集

SPECIAL
FEATURE

様々なニーズに 新しい組織で応えたい



フジミでは中長期経営計画の実現に向けたステップとして、急激な変化に対応できる組織づくりに取り組んでいます。今回の特集では、その狙いを関代表取締役社長に聞くとともに、各事業の責任者に新たな組織での抱負を聞きました。

Q 4月から従来の営業本部・技術本部を廃止し、お客様の業界別に営業と開発を一体化した事業本部を発足されましたが、今回の組織変更の大きな狙いは何でしょうか？

ここ数年、原料価格の上昇やリーマンショックなど不況による影響、また、高いシェアを誇ってきた分野において競争が活発化する中で、当社製品は必ずしも安泰とはいえない状況になってきています。それに加え、半導体の微細化に伴い、お客様が要求する技術レベルが著しく高度化するなど、従来の体制だけでは十分に答えきれなくなってきています。

今回、急速に変化するお客様の技術的なニーズにお応えし、高い品質の新製品を速やかに提供することができる組織に変更しました。

外部環境の変化に迅速に対応していくため、事業本部として営業部門と開発部門を一体化し、マーケティング

と商品開発力の強化を図っていきます。

また、一人の事業責任者が営業部門と開発部門を統括することで、意思決定の迅速化につながる大きなメリットとなります。

Q フジミの風土改革と今回の組織変更の関係をどのように捉えればよいのでしょうか？

当社は、株主様をはじめとするステークホルダーの皆様の期待にお応えするには、会社の持続的成長が不可欠であると認識しております。

そのためには、今まで以上に経営陣をはじめ社員一人ひとりが主体的にお客様の立場で考え、日々の業務を遂行することが重要です。

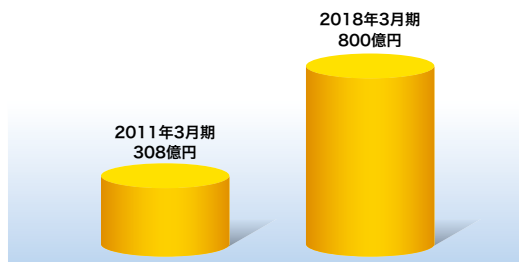
また、新たな組織とすることにより、フジミ全体の意識が変わることが企業風土の改革に繋がることを期待しています。

Q 最終年度を2018年3月期とする中長期経営計画と今回の組織変更の関係をどのように捉えればよいでしょうか。

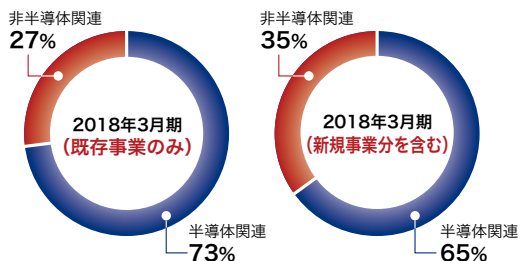
2009年からはじまった中長期経営計画では、既存事業における用途の拡大や新規事業の育成を目標に掲げていますが、ビジョン実現のためには、事業ごとにマーケットに密着した戦略を立てることが求められます。

そこで、責任体制を明確化しより迅速な意思決定ができるよう組織を事業ごとに改編いたしました。

中長期経営計画経営目標



事業構造ビジョン(売上構成比)



事業責任者への2つの設問

Q1 担当している事業とはどのような事業でしょうか。また、事業環境はどのような状態でしょうか。

Q2 新たな組織での抱負をお聞かせください

シリコン事業

A1 シリコン事業は、半導体基板であるシリコンウェハーの表面微細加工に使用される高精度研磨材の開発・販売・技術サービスの提供をおこなう当社の主力事業です。近年、半導体回路集積度向上に伴い、表面加工の微細化が常に求められ、当社製品は市場においてなくてはならない存在であり、半導体産業の成長に貢献していると自負しています。

昨年、シリコンウェハーの出荷枚数は面積換算で過去最高を記録しました。しかし、市場では低価格化が進んでおり、当社にとってシリコンウェハー加工におけるコスト低減は最重要課題です。

また、研磨材においてさらなる費用対効果の向上がもとめられています。厳しい環境下でも、お客様の期待に応える商品開発設計をタイムリーにおこない、新商品を市場にいち早く投入できる体制を整えていくことがシリコン事業の課題です。

A2 シリコン事業発足に当たり、「お客様との価値観の共有」、「似て非なるものの創出」、「一貫した商品パスワークの繋がり」、「コスト低減限界への挑戦」をテーマに設定しました。国内外において、ますます厳しくなる競合環境の中で勝ち抜いていくためには、組織の中

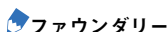
シリコンウェハー
シリコン単結晶を1mm未満の厚さにスライスし、研磨したもの。



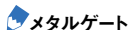
CMP
化学的機械的平坦化の略称。立体構造の電子回路の配線面の凸凹を平らにすること。



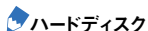
LSI
Large Scale Integrationの略。大規模集積回路。IC（集積回路）のうち、素子の集積度が1000個～10万個程度のもの。電子機器の心臓部分。



ファウンダリー
特定の半導体デバイス製造に特化した会社。



メタルゲート
高性能トランジスタは寸法を縮小するにつれ、ゲート絶縁膜も比例して薄くする必要がある。薄い絶縁膜を利用してトランジスタ性能を上げるためゲート電極を多結晶シリコンではなく金属（メタル）にする動きが広がっている。



ハードディスク
パソコンやカーナビ、DVDなどに搭載される大容量の記憶装置。アルミニウムやガラスが用いられる。

核にある開発と営業が一体となってお客様の声に耳を傾け、圧倒的な存在感を備えた商品を開発し、いち早く市場に投入し拡販することです。今後もシリコンウェハー用研磨材市場において当社がトップシェアを誇るリーディングカンパニーであり続けるためには、常に挑戦していかなければなりません。

また、東日本大震災により世界の素材調達の構図が変わろうとしている今、半導体産業に影響を与えることのない供給体制や事業構造を確立することが、私たちの使命と考えています。

CMP事業

A1 CMP事業では、**LSI**を製造する半導体デバイスメーカーのお客様に向け、CMP用研磨剤を提供しています。エレクトロニクス製品の小型化・高性能化に伴って、半導体チップの高集積化・微細化が進んでおり、配線工程においても原子レベルでの平坦化が要求されています。そうした過程で当社のCMP用研磨剤が用いられています。

今後、半導体チップの微細化・多層配線化の流れはますます加速すると予測されています。昨今は、LSIの製造を専門会社に委託する半導体デバイスメーカーが多く、**ファウンダリー**会社が伸長しています。また、合併な

どによるグローバル化の進展も顕著です。

時代の変化にいち早く対応するためには、市場の動向を詳細に分析しながら、製品開発に当たっていく姿勢が欠かせません。

A2 半導体デバイスメーカーは、200mmラインを300mmラインに移行することにより生産効率を上げ、それに加え微細化を進めています。このような状況に対応するため、CMP事業本部では、開発人員の強化と設備投資を実施してきました。

新たな組織では、営業、開発、マーケティングが一体となり、お客様ニーズの把握に努め、より迅速なアクションへとつなげていきます。

当面は、従来の用途に加え、**メタルゲート**等の新規プロセス向け製品開発にも力を入れ、将来的な売り上げアップを目指します。また、グローバルな展開として、CMP市場が拡大しているアジア地域に、さらに進出して行くことも考えられます。

ディスク事業

A1 ディスク事業は、パソコン・テレビ・DVDレコーダーなど、デジタル家電に搭載されている**ハードディスクドライブ**の記録部分である**ハードディスク基盤**

シリコン事業責任者
鈴木勝弘

CMP事業責任者
青木利一郎

を加工する研磨材を担当しています。ハードディスク市場は、お客様が扱う情報量の増大に伴い、急成長を遂げ、ディスク事業もその市場の追い風を受けて活躍の領域を広げてきました。今後、一部のデジタル家電市場が半導体メモリへと置き換わっていく中でも、大量の情報を記録できるハードディスク市場は継続して成長していくと予想されます。

リーマンショック以降、世界的な規模でビジネス環境が激変しましたが、ハードディスク市場も例外ではありません。市場では高品質な研磨材が求められており、営業と開発の連携を強化することにより、環境変化に柔軟に対応していきたいと考えています。

A2 今回、開発部門と営業部門が一体となったことにより、お客様の意向を直接汲み取った商品設計が、よりスムーズに行えるのではないかと考えています。技術的進歩の早いディスク業界においては、お客様のニーズを即座に商品に反映させていくスピード感が欠かせません。そのためには、お客様に密着した開発体制をつくり上げることが重要となります。

また、ディスク事業では収益状況の改善が求められており、現状打破のためには挑戦し続ける姿勢が必要と感じています。さらに、お客様の海外拠点であるマレーシアに当社も製造工場を保有しており、より積極的なお客様対応を図っていきたくと思っています。

機能材事業

A1 機能材事業は、半導体以外のさまざまな用途に対応した機能材料事業の推進と、新規事業の創出を担う本部として、新たに発足しました。

機能材事業の既存商品には、水晶の研磨から**太陽電池用シリコン**の切断にいたるまで幅広く使用されている**パウダー系**研磨材、ガラスやプラスチックの鏡面仕上げに用いられている**スラリー系**研磨剤、光学レンズ用**ペレット**などの固形研磨材、触媒や絶縁材料に用いられる様々なセラミックスパウダーなどがあります。また、機能材事業では1,000種を越える幅広い商品を取り揃えていますが、これは当社全体が抱える商品数の約6割に当たります。

新規事業としては、目下のところ、環境・エネルギー・代替資源分野を中心に、省エネ・CO2削減で注目を集める**LED照明用**や**パワーエレクトロニクス用**の研磨材、**レアアース**代替材料などの開発に注力しています。LEDに用いられるサファイア用研磨剤は昨年度の売上が前年度比1.6倍に成長しました。そのほかにも、新規事業創出プロジェクトなどを通じて、フジミの強みが活かせる、さまざまな事業機会を探っています。



ディスク事業責任者
大脇 寿樹

機能材

太陽電池、水晶、サファイアなどさまざまな用途向けにお客様の要望に応じた形で先端産業分野へ付加価値を提供する当社製品の総称。

太陽電池

太陽光エネルギーを電力に変換する電力機器。半導体ウェハーの原材料と同じ単結晶・多結晶シリコンを切断して基板(セル)をつくり、太陽電池パネルにする。

パウダー

粉体、砥粒

スラリー

粉体と液体を混合したものの。

ペレット

砥粒、特殊配合の金属粉末(ブロンズ系、スチール系等)、及び(又は)レジン等のボンドを混合圧縮し、熱処理した焼結体。

LED

Light Emitting Diodeの略。順方向に電圧を加えた際に発光する半導体素子のことで発光ダイオードと呼ばれる。省エネの照明などに用いられる。

パワーエレクトロニクス

電力用半導体素子を用いた電力変換、電力開閉に関する技術を扱う工学で、電力変換と制御を中心とした応用システム。

レアアース

サマリウムやネオジム、ユロピウムなどの希土類元素 (rare earth elements) の酸化物や塩化物などの総称。

A2 機能材事業には1,500社を越えるお客様、数多くの商品ラインナップとそれに付随する技術があります。これらの財産を大切にしながら、市場と技術の両軸で枠を広げ、発展させていくことが大事だと考えます。

新体制のもと、営業と開発共に力を合わせ、機能材事業が「新規事業のゆりかご」となって、次々に新しい事業を世の中に送り出せるよう本部全員が一丸となって邁進いたします。

溶射材事業

A1 溶射は、寿命を延ばしたい部品や製造装置にセラミックや金属さらにサーメット(セラミックと金属の複合材)などの膜を形成し、耐熱・耐磨耗・耐腐食という3大特性を活かし、3R(Reuse, Recycle, Reduce)に貢献する環境にやさしい技術で、鉄鋼・自動車・航空機・化学プラント・半導体など様々な業界でご利用いただいています。

溶射技術は約100年前にスイスで開発され、日本には約90年前に導入されております。フジミは、溶射材の製品を市場に投入して約11年と歴史が他事業に比べ浅いです。

私たち溶射材事業は、お客様のニーズをいち早く把握

共有するために、営業・開発・製造などの機能を持ち、溶射装置や色々な評価装置を駆使し、出来るだけお客様と同じ目線で材料設計を行い、迅速にお応えすべく日夜奮闘しています。また、従業員が一丸となって、世界一の溶射材メーカーになる夢を共有し、活気ある活動で拡大し続けています。

A2 今回は、急激な環境変化に迅速かつ的確に対応する為の組織変更です。今まで以上にお客様の声をいち早く的確に把握し、営業・開発・製造が一体となって、お客様目線での迅速な対応が可能になると考えています。

ここ近年、リーマンショック、レアアースの輸出制限や価格暴騰、円高長期化、東日本大震災など厳しい事業環境ではありますが、前期は過去最高に近い売上を確保することが出来ました。

しかし、事業規模としては小さいため、溶射材事業部は現在事業本部の位置づけではなく生産本部に所属しています。その様な状況の中、半導体比率の高いフジミにおいて非半導体が主力の溶射材事業の拡大は、バランスのよい全社事業構造に貢献するものであり、中長期経営計画を達成し、将来名実ともに事業本部の一つとして活動出来るよう展開して参ります。



機能材事業責任者
森永均



溶射材事業責任者
織田恒樹



NEWS & TOPICS ニュース & トピックス

創業60周年記念配当を実施

昨年10月、当社は創業60周年を迎えました。日頃からご支援いただいている株主の皆様には感謝の意を表すために、平成23年2月開催の取締役会において、創業60周年記念配当を実施することを決議いたしました。この結果、平成23年3月31日を基準日とする期末配当は、5円の記念配当を加えた1株当たり20円となります。

	年間配当金 (円)		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 <small>(平成22年5月11日公表)</small>	15円	15円	30円
当期実績	15円	20円 <small>(普通配当 15円) (記念配当 5円)</small>	35円
前期実績 <small>(平成22年3月期)</small>	15円	15円	30円

自己株式を取得しました

当社は平成22年12月、会社法第165条第2項の規定に基づき、自己株式の買い付けを行いました。今回取得した株式数は800,000株で、取得総額は1,028,000,000円となりました。これにより、経営・財務戦略の自由度が高まり、経営環境の変化にも迅速かつ柔軟に対応できる体制が整いました。

(1) 取得対象株式の種類	当社普通株式
(2) 取得した株式の総数	800,000株
(3) 取得価額	総額 1,028,000,000円 1株につき 1,285円
(4) 取得日	平成22年12月16日
(5) 取得方法	名古屋証券取引所の自己株式立会外買付取引(N-NET3)による買付け

航空宇宙産業における品質マネジメントシステム (JIS Q 9100) 認証取得を計画

当社の溶射材事業では、航空宇宙産業における品質マネジメントシステム(JIS Q 9100)の認証所得(2011年6月取得)をめざし、現在準備を進めています。JIS Q 9100とは、品質マネジメントシステムの国際規格であるISO 9001に、航空宇宙産業に特有の要求事項が追加された国際規格IAQS 9100の日本規格です。当社は、2000年に溶射材事業を立ち上げて以来、航空宇宙産業への本格的な参入を検討してきました。今回の認証取得が実現すれば、高度な品質が求められる航空宇宙産業の分野においても、高い品質管理能力を世界に証明することが可能となり、より一層の信頼性向上と業績の拡大が期待できます。



用語解説

国際規格IAQS 9100の日本規格: 米国ではAS9100、欧州ではEN9100という互換規格があり、相互認証されています。

用途別の動き

暮らしを楽しく、便利にするパソコン、携帯電話、DVDなどのデジタル家電。この心臓部に使用されている半導体部品の土台がシリコンウェハー（半導体基板）です。このウェハーをいかに高精度に鏡面研磨できるかが、エレクトロニクス製品の性能を大きく左右する重要なポイントです。フジミは、人造研磨材の専門メーカーとして、シリコンウェハーや半導体デバイスの製造工程に欠かせない研磨の分野で、人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献していきます。



シリコンウェハー用

パソコンを中心に、電子・IT 関連機器の心臓部に使用されている半導体部品の土台がシリコンウェハー（半導体基板）です。このウェハーをいかに高精度に鏡面研磨できるかが、エレクトロニクス製品の性能を大きく左右します。当社の主力事業であるシリコンウェハー用製品は、一般向けパソコン需要が市場予想を下回り、一部在庫調整の影響を受けたものの、ウェハーの堅調な需要に支えられ、ラッピング用研磨材とポリシング用研磨材を合わせ売上高は11,656百万円、前期比5.6%増となりました。

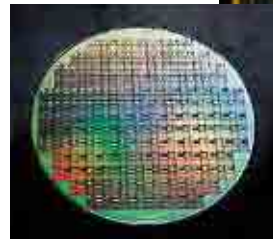


半導体の基板であるシリコンウェハー。現在の主流は、直径300mmの大口径となり、表面を高精度に磨き上げるために当社の超精密研磨材が使われています。

CMP用

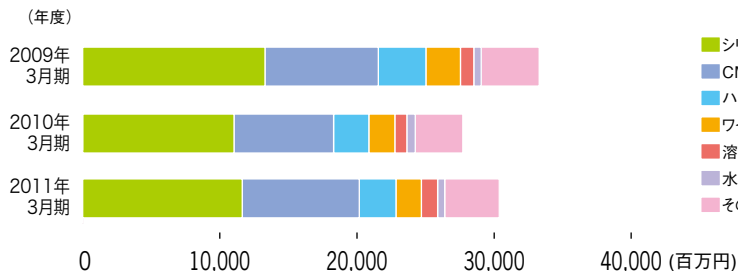
半導体の高集積化・微細化に伴う多層配線技術に使用されるCMP（化学的機械的平坦化）用製品は、長年にわたるシリコンウェハー用ファイナルポリシング材のノウハウを応用して開発された製品群です。エレクトロニクス製品の小型化とともに高機能化・高性能化が急速に進み、半導体チップはますます高集積化・微細化が求められています。その際に使用されるCMP用製品は、今後も引き続き高成長が期待される分野です。国内外のデバイスメーカーへの出荷が引き続き堅調に推移し、売上高は8,532百万円、前期比17.5%増となりました。

さまざまな情報通信機器やエレクトロニクス製品の技術進展が加速する中、半導体チップはますます小さく、その配線は細くなっています。肉眼では見えない細かな配線は今では10～12層にも積み上げられ、その製造過程において、CMP研磨は欠かせることができません。

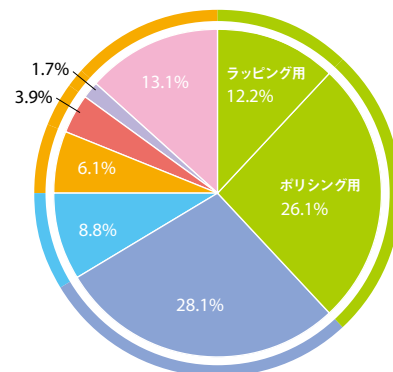


用途別製品 売上高推移

※グラフは商品を含めない自社製品みの売上高です。



2011年3月期 事業別売上高比率



ハードディスク用

ハードディスクは、パソコンの記憶装置としてはもちろん、ブルーレイディスク (BD)/DVDレコーダー、デジタルビデオカメラ、携帯音楽端末、カーナビなどにも搭載されています。デジタル家電の高機能化に伴い、プログラムやデータの高速読み出しが可能な小型・大容量のハードディスクの需要が高まり、ディスクの表面研磨は、シリコンウェハー同等もしくはそれ以上の面精度が要求されています。

一部在庫調整の動きはあったもののハードディスクの堅調な需要に支えられ、売上高は2,689百万円、前期比4.6%増となりました。



写真や映像を手軽に加工したいという市場ニーズが高まり、技術革新が進んだことで、パソコン、デジタルカメラ、携帯電話などのデジタル家電は、より多くの情報が記憶できるようになりました。それに伴い、記憶装置であるハードディスクの研磨面にも今まで以上の高いレベルが求められています。

ワイヤーソー用、溶射材、水晶デバイス用、その他の用途

単結晶・多結晶のシリコンインゴット (塊) から厚さ1ミリ未満のウェハーに切断するため使用されるワイヤーソー用砥粒。主にシリコンウェハーの切断や太陽電池用シリコンの切断に使われていますが、安価な中国品など新興国製品による影響から、売上高は1,846百万円、前期比2.7%減となりました。溶射材は、建設機械部品や鉄鋼分野の各種ロール、半導体製造装置など、耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性を高める用途に使われています。主力であるサーメット溶射材及びセラミックス溶射材を中心に製品の拡販に努め、売上高は1,188百万円、前期比35.6%増となりました。一方、水晶デバイス用は水晶振動子などの研磨に使われていますが、携帯電話や自動車向け需要はあったものの、市場価格下落の影響を受け、売上高は522百万円、前期比15.0%減となりました。



シリコンや太陽光発電用のセルの切断、携帯電話・デジタルカメラなどでのスイッチや周波数制御をする水晶部品の研磨・切断にも当社製品が使われています。溶射材はさまざまな機械部品の耐久性を高める皮膜として注目されています。

連結財務諸表

(単位：百万円)

売上高

半導体シリコンウェハー向け、CMP (化学的機械的平坦化) スラリー向けなど当社主力製品は堅調な重要に支えられ、売上高は前年比9.6%増の30,869百万円となりました。

営業利益

売上高の増加とともに、減価償却費の減少及びコスト削減に努めた結果、営業利益は前年比85.6%増の2,777百万円となりました。

当期純利益

法人税等の増加があったものの特別損失が減少したことにより、当期純利益は前年比56.7%増の1,820百万円となりました。

連結損益計算書	2010年3月期	2011年3月期
売上高	28,177	30,869
売上原価	20,573	21,362
販売費及び一般管理費	6,107	6,729
営業利益	1,496	2,777
営業外収益	225	125
受取利息/配当金	53	57
その他	171	68
営業外費用	22	85
支払利息	16	12
その他	6	72
経常利益	1,699	2,817
特別利益	220	54
特別損失	452	107
税金等調整前当期純利益	1,467	2,764
法人税、住民税及び事業税	546	828
法人税等調整額	△255	97
少数株主利益	14	17
当期純利益	1,161	1,820

(単位：百万円)

連結貸借対照表	2010年3月期	2011年3月期
資産の部		
流動資産	29,617	30,396
現金及び預金	13,835	12,468
受取手形及び売掛金	8,027	6,820
たな卸資産	4,676	5,048
その他	3,188	6,216
貸倒引当金	△110	△157
固定資産	17,844	16,338
有形固定資産	15,239	13,919
無形固定資産	331	305
投資その他の資産	2,273	2,113
資産合計	47,462	46,734

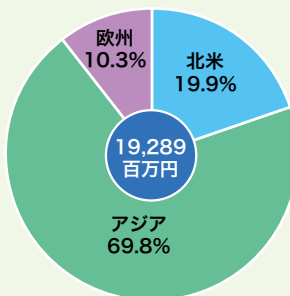
(単位：百万円)

連結貸借対照表	2010年3月期	2011年3月期
負債の部		
流動負債	5,763	5,714
支払手形及び買掛金	3,335	2,905
短期借入金	184	81
その他	2,243	2,727
固定負債	271	217
負債合計	6,035	5,932
純資産の部		
株主資本	42,170	42,100
資本金	4,753	4,753
資本剰余金	5,069	5,069
利益剰余金	35,111	36,069
自己株式	△2,764	△3,792
その他の包括利益累計額	△998	△1,565
新株予約権	63	61
少数株主持分	191	205
純資産合計	41,426	40,802
負債純資産合計	47,462	46,734

(単位：百万円)

海外売上高	2010年3月期	2011年3月期
海外売上高	16,101	19,289
連結売上高	28,177	30,869
連結売上高に占める割合	57.1%	62.5%

海外売上高構成比 (2011年3月期)



* 各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりです。

北 米： アメリカ、カナダ

アジア： 台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、韓国、中国

欧 州： ドイツ、イタリア、イギリス

連結財務諸表

(単位：百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は、4,342百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,764百万円、減価償却費1,991百万円など資金の増加項目が、たな卸資産の増加額561百万円、法人税等の支払額837百万円など資金の減少項目を上回ったことなどによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は、471百万円となりました。前期に比べ1,123百万円減少となりました。これは主に定期預金の払戻による収入1,500百万円があったものの、定期預金の預入による支出1,505百万円及び有形固定資産の取得に関する支出508百万円があったことなどによるものです。

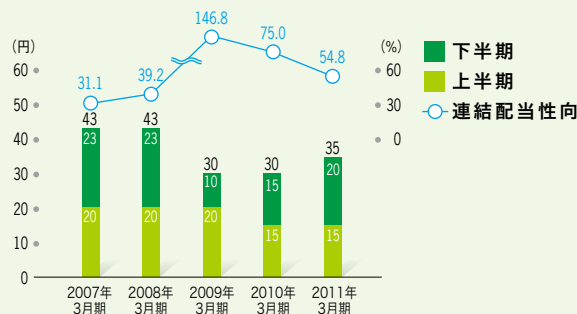
財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は2,073百万円となりました。自己株式の取得による支出1,028百万円及び配当金の支払額が862百万円あったことなどによるものです。

配当金及び連結配当性向の推移

当社は、株主に対する適正な利益還元を行うことを経営の重要課題と認識し、配当につきましては、安定配当にも留意し30%以上の連結配当性向を目標とし、業績に応じた積極的な株主還元に取り組んでまいりました。このような方針のもと、当期末配当金は、当社60周年の記念配当金5円を加えました1株につき20円とし、年間配当金は、1株につき35円といたしました。

連結キャッシュ・フロー計算書	2010年3月期	2011年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,768	4,342
税金等調整前当期純利益	1,467	2,764
減価償却費	2,448	1,991
売上債権増減額(△は増加)	△2,081	1,036
仕入債務増減額(△は減少)	856	△289
たな卸資産増減額(△は増加)	2,656	△561
その他	597	173
小計	5,944	5,115
利息及び配当金の受取額	51	68
補助金の受取額	99	—
法人税等の支払額	△135	△837
その他	807	△4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,594	△471
定期預金の預入による支出	△1,500	△1,505
定期預金の払戻による収入	150	1,500
有形固定資産の取得に関する支出	△256	△508
無形固定資産の取得に関する支出	△90	△63
その他	102	106
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,450	△2,073
短期借入金の純増加(減少)額	37	△87
長期借入金の純増加(減少)額	△93	△87
自己株式の取得による支出	△675	△1,028
親会社による配当金の支払額	△729	△862
その他	10	△7
現金及び現金同等物に係る換算差額	17	△171
現金及び現金同等物の増加(減少)額	3,740	1,626
現金及び現金同等物期首残高	10,899	14,639
現金及び現金同等物期末残高	14,639	16,265



株式情報

2011年3月31日現在

株式の状況

株式数	発行可能株式総数	120,000千株
	発行済株式総数	30,699千株
	株主数	6,975名

大株主

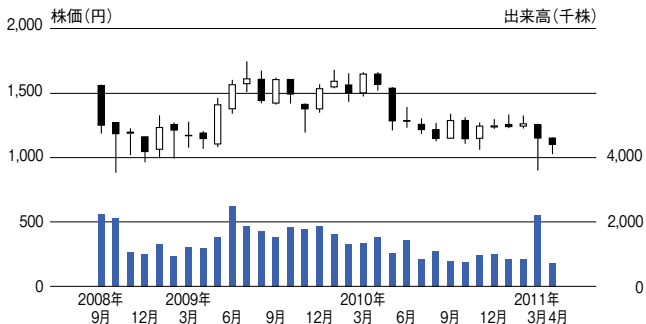
株主名	持株数	持株比率
越山 勇	2,902千株	9.4%
株式会社フジインコーポレーテッド(自己株口)	2,760	8.9
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,647	5.3
有限会社コマ	1,638	5.3
野田 純孝	1,520	4.9
越山 彰	1,151	3.7
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,023	3.3
日本生命保険相互会社	779	2.5
株式会社三菱東京UFJ銀行	728	2.3
株式会社りそな銀行	691	2.2

役員

2011年6月22日現在

代表取締役社長	関 敬史
取締役	土屋太加志
取締役	伊藤 広一
取締役	鈴木 彰 (新任)
常勤監査役	石井 和廣
常勤監査役	松島 伸男 (新任)
監査役	鮎澤 多俊
監査役	高橋 正彦 (新任)

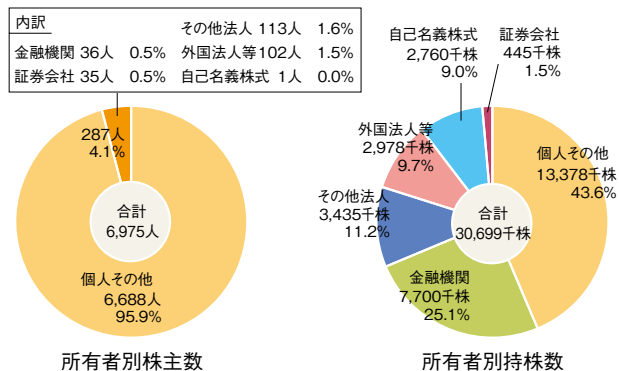
株価および出来高の推移



* 株価データは、株式分割を過年度に遡り調整した修正株価を使用しています。

株主分布状況

2011年3月31日現在



会社データ

2011年3月31日現在

商号	株式会社フジミンコーポレーテッド
証券コード	5384
本社所在地	愛知県清須市西枇杷島町地領2-1-1 TEL. 052-503-8181 (代表)
設立年月日	1953年(昭和28年)3月20日
資本金	47億5,343万8,500円
代表者	代表取締役社長 関 敬史
従業員	742名(個別581名)

株主メモ

2011年6月23日現在

決算期	3月31日
基準日	3月31日
単元株式数	100株
公告方法	電子公告 (http://www.fujimiinc.co.jp) ただし、事故その他やむを得ない事情によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載することといたします。
株主名簿管理人	〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先 および照会先	〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(フリーダイヤル)

株式会社フジミンコーポレーテッド

お問い合わせ先：経営企画部企画課
TEL：052-503-8181 (代表)
URL：<http://www.fujimiinc.co.jp>

Copyright (C) 2011 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

各種手続のお申出先

- 支払期間経過後の配当金のお支払いについては、株主名簿管理人にお申出ください。
- 住所変更、単元未満株式の買取、配当金受取方法の指定等
証券会社をご利用の株主様は、お取引の証券会社へお申出ください。
証券会社をご利用でない株主様は、特別口座の口座管理機関である日本証券代行株式会社へお申出ください。

【ご注意】

特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、日本証券代行為口座管理機関となっておりますので、下記特別口座の口座管理人に、お問合せください。

特別口座管理機関 連絡先	日本証券代行株式会社 〒137-8650 東京都江東区塩浜二丁目 8番18号 電話 0120-707-843 (フリーダイヤル)
-----------------	---



適切に管理された森林から
取り出された木材を使用しています

この印刷物は、環境負荷低減のため適切に管理された認証パルプと古紙パルプを5%以上使用した環境対応紙と、植物油を使用し、VOCの排出を抑えた環境対応型リサイクルインキ「ベジタブルインキ」を使用しています。